

TIF™100L-3550-06系列是一种陶瓷粉末填充硅胶导热材料，它能填充发热器件和散热片或金属底座二者之间的间隙。它的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上，从而提高发热电子组件的效率和使用寿命。

特性

- 》 超低挥发D3~D20低分子硅氧烷
- 》 良好的热传导率
- 》 带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》 高可压缩性, 柔软兼有弹性, 适合于低压力应用环境
- 》 可提供多种厚度选择
- 》 LED电视, 灯具

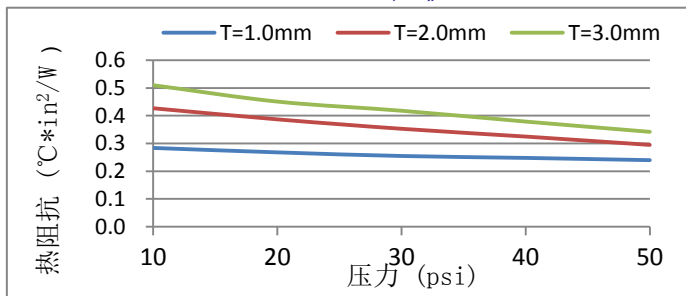
应用

- 》 光学器件、摄像头镜头部位
- 》 散热器底部或框架
- 》 机顶盒
- 》 电源与车用蓄电电池
- 》 充电桩
- 》 LED电视, 灯具
- 》 显卡模组

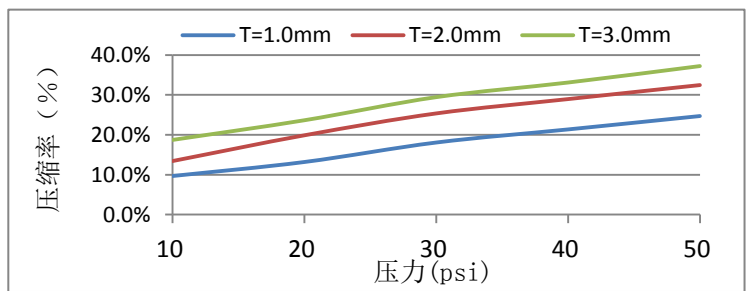
TIF™100L-3550-06 系列特性表

产品特性	典型值	测试方法
颜色	白色	Visual
结构&成份	陶瓷填充硅胶	*****
厚度范围	0.010"(0.25mm)~0.200" (5.0mm)	ASTM D374
硬度 (Shore 00)	50±5	ASTM 2240
比重 (g/cc)	3.1	ASTM D297
使用温度范围	-40~200℃	*****
拉伸强度 (psi)	≥17	ASTM D412
击穿电压 (T=1.0mm, Vac)	≥6000	ASTM D149
体积电阻率	≥1.0X10 ¹³ Ohm-cm	ASTM D257
导热系数 (W/mK)	3.5	ASTM D5470
	3.5	ISO22007-2.2
防火等级	94 -V0	UL E331100
低分子挥发	ND	130℃,24H
出油率	<8%	ASTM G120-01
储存条件	10℃~40℃, RH30%~90%	*****
储存周期	12个月	*****

热阻抗



压缩率



标准厚度:0.010"(0.25mm)~0.200" (5.0mm)

标准尺寸:8"×16" (203mm×406mm)

TIF系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息, 请与本公司联系。

安全处置方法无需特别防护, 存储方法低温干燥, 远离明火, 避免阳光直射即可, 详细方法可参考产品物质安全资料表。

导热材料

导热工程塑料

发热材料

屏蔽材料

发泡硅胶

模切制品

加拿大:
Tel:+001-604-2998559
E-mail: sales@thermazig.com

中国:
Tel: +86-769-38801208
E-mail: frances@ziitek.com.tw

台湾:
Tel:+886-2-22771007
E-mail:frances@ziitek.com.tw



2021/08/18

以上资料与说明是兆科实验室测试所得, 结果准确可靠, 但不作为法律的解释或保证, 用户须进行充分的测试与确认上述讯息适合用户所提出任何特殊的产品与应用。